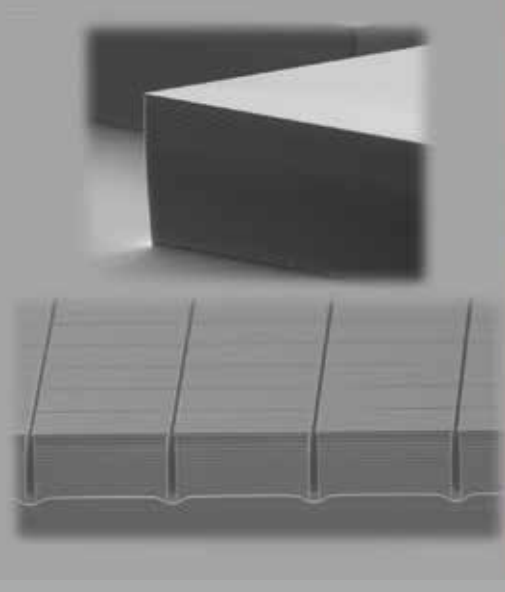




기종명

APX300

(Dicer Modular)

품번: NM-EFE4AA-D

Plasma Dicer

- 웨이퍼 전면을 손상 없이 일괄적으로 Dicing하여 강도 높은 Chip 분할을 실현합니다.
- 파나소닉의 독자적인 프로세스로 다양한 종류의 반도체 웨이퍼를 Dicing할 수 있습니다.
- 생산량에 맞추어 Single Chamber 시스템에서 Multi Chamber 시스템(*1)으로 전개가 가능합니다.

기종명	APX300 (*2)
품번	NM-EFE4AA-D
플라즈마원	ICP 플라즈마
프로세스가스	표준 4계통 (최대 6계통까지 증설 가능: 불소계 가스, Ar, O ₂ , He 등)
처리대상웨이퍼 ^{※1}	표준 $\phi 200$ mm, 혹은 $\phi 300$ mm (링 프레임 포함)
설비크기 ^{※2}	W 1,350 mm × D 2,230 mm × H 2,000 mm (Single Chamber 시스템(옵션 반송 유닛 연결 사양)) ^{※3}
설비무게	2,330 kg (장치 구성에 따라 상이할 수 있습니다.)
전원 ^{※4}	3성 AC 200 / 208 / 220 / 230 / 240 ± 10 V, 50 / 60 Hz, 21.0 kVA
공압원	0.5 MPa ~ 0.7 MPa, 250 L/min (A.N.R.)
N ₂ 원	0.1 MPa ~ 0.2 MPa, 50 L/min (A.N.R.)

※1: 기타 사이즈의 웨이퍼에 대해서는 별도 문의주시기 바랍니다.

※2: 터치 패널, 조작 패널, 시그널 타워, 배관 등의 돌출부 및 드라이 펌프, 칠러 등의 주변 기기는 포함되지 않은 사이즈입니다.

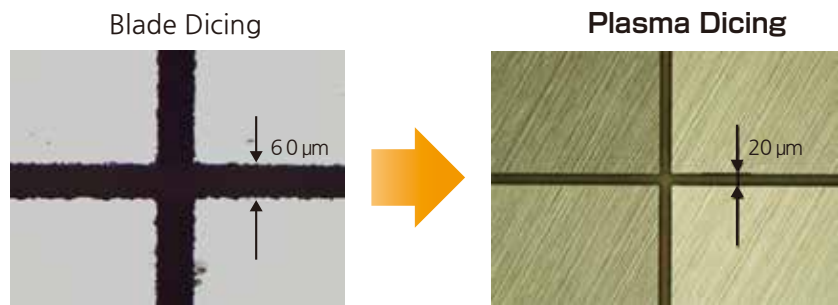
※3: 반송 유닛(옵션)은 전용 카세트로의 진공 로드 락 공급 사양입니다.

※4: 3상 전원은 2계통이며, 그 합계를 나타냅니다. 드라이 펌프, 칠러 등 주변 기기는 포함되어있지 않습니다.

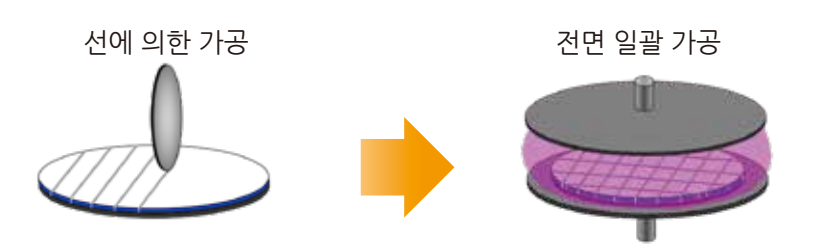
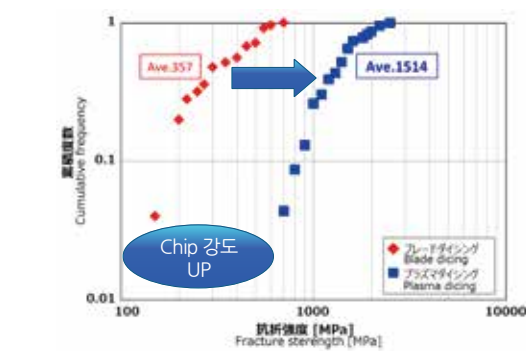
(*1) 당사 지정 반송 기기와의 연결이 필요합니다. 자세한 사항은 별도 문의주시기 바랍니다.

(*2) 자세한 사항은 사양서를 참조해주시기 바랍니다.

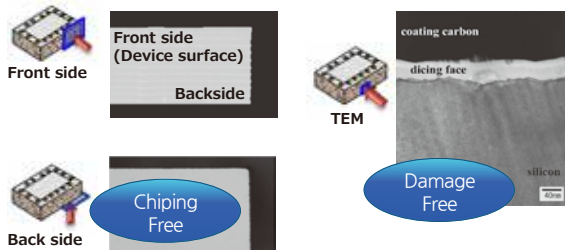
Chip의 취득 수 증가·전면 일괄로의 고속 가공 **Chip 강도 향상**



Dicing 폭 최소화

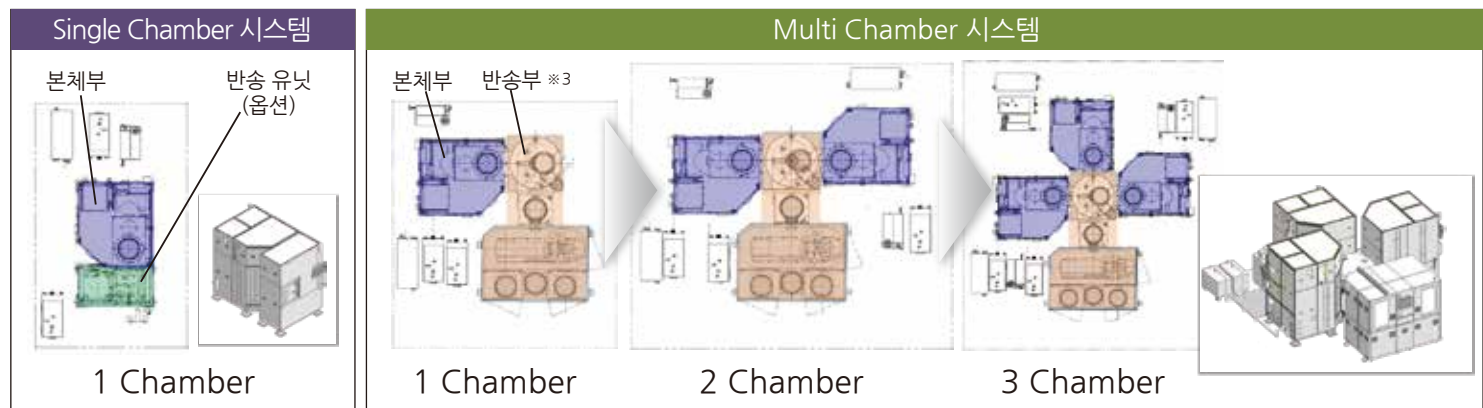


웨이퍼 전면 일괄 Dicing



Damage-free Dicing

고객의 생산 규모에 유연하게 대응
 - Single Chamber 시스템에서 Multi Chamber 시스템으로 전개 가능 -



※3: 당사 지정 반송 기기와의 연결이 필요합니다. 자세한 사항은 별도 문의해주시기 바랍니다.

⚠ 안전에 관한 주의사항

● 제품을 사용하실 때에는 취급설명서를 숙지한 후 올바른 방법으로 사용해주시요.

● 본 카탈로그에 기재된 제품의 안전한 사용을 위해 설비의 가동·정지에 관계없이 설비에 첨부된 취급설명서 및 설비에 부착된 경고 문구를 충분히 확인하신 후, 올바른 조작을 부탁드립니다.

Panasonic은 친환경 제품 만들기에 최선을 다 하고 있습니다

자세한 사항은,
panasonic.com/global/corporate/sustainability

문의 사항 기재란

Panasonic Corporation
 Process Automation Business Division

3-1-1 Inazu-cho, Toyonaka City, Osaka 561-0854, Japan
 TEL +81-6-6866-8675
 FAX +81-6-6862-0422

본 자료의 기재 내용은
 2021년 1월 1일 기준입니다.

Ver.2021.1.1

© Panasonic Corporation 2021